ON Semiconductor®

Final Product/Process Change Notification

Document # : FPCN22630X
Issue Date: 26 March 2019

Title of Change:	Qualify ASE Kunshan as alternative test site for SOIC8/16.
Proposed first ship date:	3 July 2019
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Marquita.Jones@onsemi.com>
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>
Change Part Identification:	Product marked with date code 1912 or later may be tested from ASE Kunshan or from OSPI Carmona.
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☐ Assembly Change ☑ Test Change ☐ Other _____

Change Sub-Category(s):

☑ Manufacturing Site Addition	☐ Material Change	☐ Datasheet/Product Doc change
☐ Manufacturing Site Transfer	☐ Product specific change	☐ Shipping/Packaging/Marking
☐ Manufacturing Process Change		☐ Other: _____

Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Carmona, Philippines	External Foundry/Subcon Sites: ASE Kunshan

Description and Purpose:

ON Semiconductor would like to inform its customers of the qualification of ASE Kunshan for the test of SOIC-8/16 products listed in this Final Product Change Notification (FPCN). This is a capacity expansion and at the end of the FPCN approval cycle, these products may be dual source tested at either ASE Kunshan or OSPI Carmona.

There are no product material changes as a result of this change

Reliability Data Summary:

There is no reliability required for this type of change.

Electrical Characteristic Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal.**

Part Number	Qualification Vehicle
NCP1380BDR2G	NCP1380BDR2G
NCP1380CDR2G	NCP1380BDR2G
NCP1380DDR2G	NCP1380BDR2G
NCP4304ADR2G	NCP4304ADR2G
NCP4304BDR2G	NCP4304ADR2G
NCP4303ADR2G	NCP4303BDR2G
NCP1605DR2G	NCP1605DR2G
NCP1605BDR2G	NCP1605DR2G

Japanese translation of the notification starts here.

通知の日本語訳はここから始まります。

Note*: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます.

ON Semiconductor®

最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22630X
発行日 : 26 March 2019

変更件名 :	SOIC8/16 用の代替のテスト拠点として ASE Kunshan (昆山) の認定。
初回出荷予定日 :	3 July 2019
連絡先情報 :	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Marquita.Jones@onsemi.com> にお問い合わせください。
サンプル :	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。
通知種別 :	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知（FPCN）です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。 お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。
変更部品の識別 :	日付コード 1912 以降の日付表示がある製品は、ASE Kunshan (昆山) または OSPI Carmona (カルモナ) からテストすることができます。
変更カテゴリ :	☐ ウェハファブの変更　☐ アセンブリの変更　☑ 試験の変更　☐ その他 _____

変更サブカテゴリ :

☑ 製造拠点の追加	☐ 材料の変更	☐ データシート/製品資料の変更
☐ 製造拠点の移転	☐ 製品仕様の変更	☐ 出荷/パッケージング/表記
☐ 製造プロセスの変更		☐ その他 : _____

影響を受ける拠点 :	オン・セミコンダクター拠点 : ON Carmona, Philippines	外部製造工場 / 下請業者拠点 : ASE Kunshan

説明および目的 :

オン・セミコンダクターは、この最終製品変更通知 (FPCN) に記載されている SOIC-8/16 製品のテスト拠点として、ASE Kunshan (昆山) の追加をお客様にお知らせします。これによって生産能力が拡大され、FPCN 承認サイクルが完了した時点で、該当の製品は ASE Kunshan (昆山) または OSPI Carmona (カルモナ) のいずれかのデュアルソースでのテストが可能になります。

今回の変更に伴う製品材料の変更はありません。

ON Semiconductor®

最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# :FPCN22630X
発行日:26 March 2019

信頼性データの要約:

この変更種別に必要な信頼性はありません。

電気的特性の要約:

電気的特性に影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ビークル
NCP1380BDR2G	NCP1380BDR2G
NCP1380CDR2G	NCP1380BDR2G
NCP1380DDR2G	NCP1380BDR2G
NCP4304ADR2G	NCP4304ADR2G
NCP4304BDR2G	NCP4304ADR2G
NCP4303ADR2G	NCP4303BDR2G
NCP1605DR2G	NCP1605DR2G
NCP1605BDR2G	NCP1605DR2G